

목 차

주주총회소집공고.....	1
주주총회 소집공고.....	2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항	4
1. 사외이사 등의 활동내역	4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부	4
나. 이사회내 위원회에서 사외이사 등의 활동내역	4
2. 사외이사 등의 보수현황	4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항	5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....	5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래	5
III. 경영참고사항	6
1. 사업의 개요.....	6
가. 업계의 현황	6
나. 회사의 현황	7
2. 주주총회 목적사항별 기재사항	9
□ 이사의 선임.....	9
※ 참고사항.....	10

주주총회소집공고

2019년 07월 22일

회 사 명 : 덕산하이메탈 주식회사
대 표 이 사 : 이 준 호
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 무룡1로 66(연암동)
(전 화) 052)-283-9000
(홈페이지) <http://www.dshmetal.co.kr>

작 성 책 임 자 : (직 책) 부회장 (성 명) 이 수 훈
(전 화) 052) 283-9000

주주총회 소집공고

(제21기 임시 주주총회)

주님의 건승과 다행의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 제21기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의4 및 정관 25조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2019년 8월 6일 (화) 오전 08시 00분

2. 장 소 : 울산광역시 북구 무룡1로 66 (연암동) 덕산하이메탈(주) 본사강당

3. 회의목적사항

가. 부의 안건

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 [후보자 : 김윤철]

4. 경영참고사항 등의 비치

상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를

하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증 또는 여권)

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감날인,인감증명서),
대리인의 신분증

(※단, 1% 이하 소액주주의 경우 주총참석장이 서면으로 발송되지 않으므로 주총 참석장은 지참하지 아니하셔도 되며, 신분증 또는 위임장에 기재된 인적사항과 당사에 비치한 주주명부에 의하여 권리주주임을 확인하겠습니다.)

2019 년 07 월 22 일
덕산하이메탈 주식회사 대표이사 이 준 호(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			윤대홍 (출석률: 86%)
			찬 반 여 부
1901	2019.01.30	[제1호 의안] 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고의 건	찬성
1902	2019.02.22	[제1호 의안] 제20기(2018년) 재무제표 및 영업보고서 등 승인의 건	찬성
1903	2019.02.28	[제1호 의안] 제20기 정기주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건 [제2호 의안] 전자투표제도 도입의 건	찬성 찬성
1904	2019.03.29	[제1호 의안] 임시의장 선임의 건 [제2호 의안] 대표이사 선임의 건 (김길연)	불참
1905	2019.04.10	[제1호 의안] 금전대여 결정의 건	찬성
1906	2019.06.07	[제1호 의안] 타법인[해외] 신규출자 승인의 건	찬성
1907	2019.06.25	[제1호 의안] 제21기 임시주주총회 개최 및 부의안건 의결의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

- 해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	5,000	6.2	6.2	-

※ 상기 주총승인금액은 제20기 정기주주총회에서 승인된 제21기(2010년) 이사보수한도 총액기준입니다

※ 지급총액은 '19년 1월~6월까지 기준으로 산정하였음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정 규모이상인 거래

- 해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사는 반도체 패키징 재료인 Solder Ball 등을 제조/판매하는 금속소재사업부문과 AMOLED 유기물 재료 및 반도체 공정용 화학제품을 제조/판매하는 화학소재 사업부문으로 영위하고 있었으나, 2014년 12월 30일을 분할기일로 하여 금속소재 사업부문(덕산하이메탈(주))과 화학소재사업부문(덕산네오룩스(주))을 분리하고, 금속소재 사업부문인 덕산하이메탈(주)의 경우 지주회사 역할을 추가하였습니다.

구분	회사명	사업부문	역할
분할 존속회사	덕산하이메탈 주식회사	금속소재 사업부문	지주회사 및 사업회사
분할 신설회사	덕산네오룩스 주식회사	화학소재 사업부문	사업회사

가. 업계의 현황

[지주회사 사업부문]

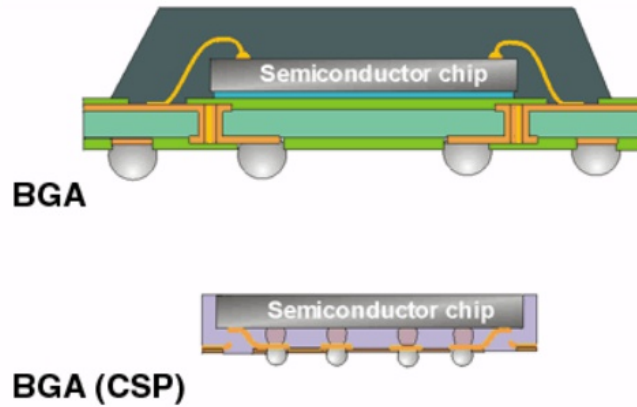
지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

지주회사의 장점으로서는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[덕산하이메탈(주) 사업부문]

(산업의 특성) 반도체의 후공정 접합 공정에 기관과 소자 등을 서로 Soldering(납땜)하는 기술이 점점 발전함과 더불어 집적화, 소형화 추세로 인해 현재 반도체 후공정에서 BGA(Ball Grid Array), CSP(Chip Scale Package) 등의 수요가 증가하고 있습니다.



BGA Package Types

These cross sections show BGA packages in standard and CSP varieties. (Illustration courtesy of Joseph Fjelstad.)

솔더볼은 이러한 반도체의 첨단 패키지 기술인 BGA, CSP용 부품으로 칩과 기판을 연결하여 전기적 신호를 전달하는 역할을 하는 반도체 패키징용 부품 소재입니다. 현재 BGA는 PC, 노트북의 안정적인 성장과 스마트폰과 소형 디지털 기기들의 성장에 기인하고 있으며, 각종 Device의 경박단소화 및 고기능화(Pin수의 증가, 입출력효율증대 등)로 Lead Frame type이 한계를 드러내 BGA, CSP, Flip chip Type으로 급선회하고 있어 솔더볼의 적용분야는 더욱 확장 될 것으로 기대하고 있습니다.

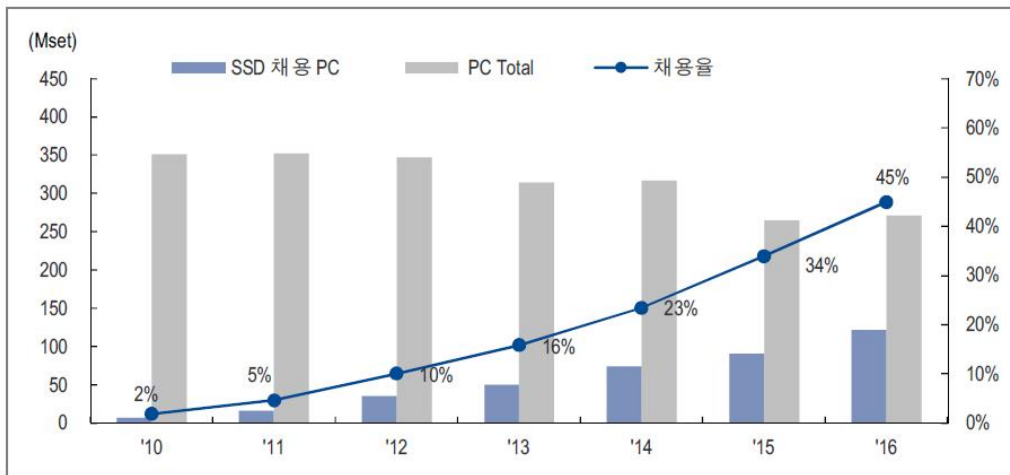
반도체 재료는 장비대비 원가 비중이 낮은 반면 공정수율 및 생산 현장에서의 신뢰성에 직결되는 특성으로 기존재료의 변경을 극도로 꺼리고 있어 신생업체의 신규 시장 진입은 매우 힘든 상황입니다. 솔더볼을 수요하는 고객사 입장에서는 재료를 변경하기 위해서는 Qualification 과정을 거치면서 Qualification cost가 발생하므로 이러한 비용을 감수하면서 양산중인 라인을 품질 검증을 위해 사용하는 것은 쉽지 않습니다. 이러한 반도체 업체의 재료업체 변경에 대한 보수적인 경향 등으로 신생업체의진입이 거의 불가능하게 되었으며, 더욱이 고객사와의 문제해결 과정에서 이루어지는 기술개발과 상호 보안상 이유 및 전 세계 BGA시장의 30~40%가량을 차지하는 한국시장에서 당사는 Local Vendor로서의 장점 등의 Synergy 효과로 인하여 업계에서 시장지배적 지위를 확보하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

솔더볼 시장은 PC시장과 스마트폰의 폭발적 성장에 더불어 동반 성장 하였으며, 현재는 과도기를 거쳐 안정적인 성장률을 보이고 있습니다. 또한 현재 반도체 패키징산업은 시스템 반도체 산업 중심 및 고부가가치 제품 위주로 성장하고 있으며 전반적인 반도체 시장과 더불어 솔더볼의 시장의 동반 성장을 기대하고 있습니다. 최근 빅데이터 확대에 따른 트래픽 증가와 더불어 SSD와 HDD의 가격 격차가 줄어들면서 PC내 SSD 탑재비중이 확대 되고 있으며 향후 SSD(Solid State Disk)의 HDD(Hard Disk Drive) 대체 수요가 확대 될 것으로 기대하고 있습니다.



자료: Gartner, NH투자증권 리서치센터 전망

또한 스마트폰 시장이 급 성장 및 대중화 되며, 스마트폰 반도체 중 가장 기술집약적인 부품으로 AP(Application Processor)칩의 사용 또한 확대되고 있습니다.

당사의 솔더볼 사업 또한 스마트폰의 성장과 더불어 성장을 하였으며, 현재 AP는 각종 Application 작동과 그래픽 처리를 담당하는 핵심 반도체로 CPU기능과 메모리, 하드디스크, 그래픽 카드 등 기타 장비의 연결을 제어하는 칩셋의 기능을 모두 포함한 SoC(System on Chip)로 스마트폰의 핵심부품으로 대두 되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

기타 덕산하이메탈(주) 외에 연결대상 종속회사에는 덕산에스지(주)가 있습니다.

구 분	회사명	주요사업	당사 지분율	비고
비상장	덕산에스지(주)	전자기기용 비산방지데코필름, 전사필름 제조업	70.8%	종속기업

주) ㈜덕산유엠티는 합병등기일 2016년 11월 9일자로 존속법인 (주)덕산테크코피아에 흡수합병된 후 해산하여, 상기 당사의 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다.

(2) 시장점유율

당사의 경쟁사로는 일본의 센쥬메탈 및 NMC, 독일의 Heraus 등이 있습니다. 솔더볼 시장은 매년 안정적인 성장률을 보이고 있으며 당사는 국내 시장의 60~70%를 점유하고 있습니다. 당사는 지속적인 원가 절감을 위한 개선 노력으로 단가의 지속적 하락에도 불구하고 매년 높은 영업이익을 기록하고 있으며 품질에 있어서도 세계 최고의 반도체 고객사들에게 품질을 인정 받아 대량 납품중입니다. 또한 솔더볼의 미세화 추세에 발맞추어 극미세 솔더볼 등의 개발을 완료, 기술 경쟁력에서도 높은 수준을 유지하고 있습니다.

당사추정으로 세계솔더볼 시장점유율은 일본이 43% / 한국 40% / 대만 12% / 기타(미국, 독일 등) 5%순으로 추정하고 있습니다. 또한 세계 시장에서 당사는 2위업체로서 위치를 점하고 있습니다. 전세계 패키징(테스트포함)업체는 한국(35%), 대만(35%), 나머지 일본, 중국, 말레이시아 등을 포함한 아시아/태평양 지역의 업체들이 주도하고 있습니다. 세계 패키징 시장은 시스템 반도체의 발전과 연동되어 성장하며, 고부가가치제품(시스템반도체) 위주로

솔과 시장이 변화되고 있습니다.

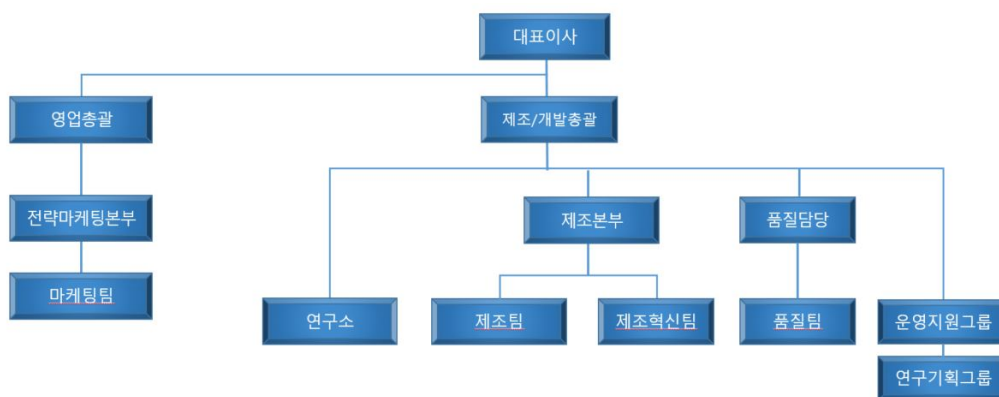
(3) 시장의 특성

솔더볼 시장은 글로벌 반도체 시장과 연계하여 현재 안정적인 성장률을 보이고 있으며, 당사는 세계 시장의 2위를 점유 중이며 대부분의 고객사가 반도체 업계의 메이저 업체입니다. 따라서 당사는 이러한 반도체 업황의 변동에 따라 직접적인 영향을 받습니다. 또한 BGA 시장은 전자부품의 활용도가 증가하면서, 경박단소화 추세 및 네트워크 통신과 ICT산업의 성장 등으로 새로운 시장이 점차 형성되고 있습니다. 반도체 칩이 과거의 컴퓨터용으로만 한정되어 있던 것과는 달리 지금은 노트북, LCD를 비롯해 스마트폰 등으로 다양화되고 있으며, 솔더볼의 수요는 이러한 반도체경기과 맥락을 같이 할 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 BGA의 핵심부품 소재인 솔더볼의 전문 개발/제조 회사로서 solder joint 부분의 차별화된 기술을 보유하고 있습니다. 당사는 수율향상 및 리드타임단축 등으로 생산성을 높이고 있으며, 신조성(고온 신뢰성, 저용점) 개발능력과 고강도볼, 저용점 L/Free alloy, 무 변색 볼 제조, 마이크로솔더볼을 통한 소형화(극미세화) 등의 기술력을 보유하고 있습니다. 또한 국내의 삼성전자(주), 애플테크놀로지, 스태츠칩팩코리아, 하이닉스반도체, 시그네틱스와 해외의 SESS(삼성중국), ATC(애플 중국), ATP(애플필리핀) 등과 공급계약 체결을 통한 절대적 시장지배를 통하여 안정적인 점유율 확대를 도모하고 있습니다. 또한 지속적인 R&D투자를 통한 제품의 성능개선 및 신제품 개발을 위해 산학연 프로젝트의 적극적 활용과 기술연구소 운영으로 Solder joint관련 원천기술을 확보하고 있으며, 신기술 개발을 통한 대외적 경쟁력 우위를 확보하고 있습니다. 또한 향후 원가경쟁력 확보 및 기술력이 패키징시장에 중요요소로 부각되고 있어 당사 또한 경쟁력 제고를 위하여 지속적인 기술개발 및 신규아이템 개발등을 통해 원천기술의 확보, 원가경쟁력 확보를 위해 노력하고있습니다.

(5) 조직도



2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김 윤 철	1958년 6월 15일	사내이사	없음	이사회
총 (1) 명				

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김 윤 철	덕산하이메탈(주) 사장 (제조/개발총괄)	- 前)덕산하이메탈 재무담당 - 前)덕산하이메탈 그룹재무담당(부사장) - 現)덕산하이메탈 사장(제조/개발총괄)	없음.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음.

※ 참고사항

해당사실이 없음.